108學年度四技進修部入學電子系產學合作班課程總表

108/06/04 校課程委員會審議通過 108/05/23 院課程委員會審議通過 108/04/03 系課程委員會審議通過

	A) II		1.	1	-下	1 -	٠١.	_	· T	三上三下										系課程委員會番議班
	科目		<u>-</u>	1	1	EXT /1	- <u>L</u>	EXT /1				=							王人數	備註
	2 稱	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	学分) 時嬰	上限	別1 :	1/13 P.L.
共	國文(Chinese)	3	3	3	3															
八同必修14學分	图文(clifficat)																			
	英文(English)	3	3	3	3															
																	+			
	英語聽講(Aural-Oral English)					1	2	1	2											
	合計	6	6	6	6	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
	微積分(Calculus)	3	3														_	4	-	
	電路學(Electric Circuit)	3	3		_												_	4	-	
i	普通物理(General Physics)			3	3	ļ											_	_	1	
	電子學(一)(Electrioncs I)			3	3												_	4	-	- 16
	產業專題(一)(Industry Special Topic I)	-		3	3	-											-	_	-	暑修
	電子電路設計實務(Electronic Circuit Design Practice)	1		3	3	1										1	+	\perp	1	暑修
	程式設計實務(Language Programming Practice)	1		3	3	1										1	+	\perp	1	暑修
	電子學(二)(Electrioncs II)	1			_	3	3										+	-	1	
	電子電路應用實務(Electronic Circuit Application Practice)	-				3	3										-	_	-	
	數位邏輯設計實務(Digital Logic Design Practices)					3	3										_	_	1	
	電子實務(一)(Electronics Practice I)					3	3										_	_	1	
	電腦輔助資料表達於工程之應用(Computer-Aided Engineering Data Presentation)	-				-		3	3								-	_	-	
	電磁學(Electromagnetics)					ļ		3	3								_	_	1	
	半導體材料科學導論(Introduction to Semiconductor Materials Science)							3	3								_	4	-	
	電子實務(二)(Electronics Practice II)							3	3								_	4	-	- L
系專	產業專題(二)(Industry Special Topic II)	-			-			3	3									-	-	暑修
	FPGA/CPLD設計實務(FPGA/CPLD Design Practices)	-				<u> </u>		3	3							-	-	+	+	暑修
業	模擬軟體應用(MATLAB)(Applications of simulation software(MATLAB))	-						3	3								_	+	+	暑修
必	固態電子學(Solid-state Electronics)	-				<u> </u>		3	3	0	2						-	+	+	暑修
修	機率與統計(Probability and Statistics)	-				<u> </u>				3	3					-	-	+	+	
116	半導體材料檢測概論(Introduction to Semiconductor Materials Characterization)	-				<u> </u>				3	3					-	-	+	+	
學	高速電路(High Speed Circuits)	1				-				3	3						-	+	+	
分	電化學方法與應用(Electrochemical Methods and Applications)	1				-				3	3	2	2				-	-	+	
	半導體封裝(Semiconductor Package)	-				<u> </u>						3	3			-	-	+	+	
	半導體元件(Semiconductor Devices)											3	3				-	-	+	
	微處理機實務(Microprocessor Practice)											3					-	-	+	
	光電工程實務(Electro-optical Engineering Practice)	1										3	3				+	+	+	見.板
	產業專題(三)(Industry Special Topic III)											3	3				-	-	+	暑修
	網路資料庫實務(Network Database Practice)	1			1	-						3	3				+	+	1	暑修
	半導體製程概論(Introduction to Semiconductor Process)	+	-	-	-	1	-	-				5	3	2	3	+	+	+	1	暑修
	半導體測試(Semiconductor Test) 可靠度工程概念(Jatraduction to Paliablity Engineering)	+	-	-	-	1	-	-						3	3	+	+	+	1	
	可靠度工程概論(Introduction to Reliablity Engineering)	\vdash			-	 	-							3	3	-	+	+		
	科技英文(Technical English)	+	-	-	-	1	-	-						3	3	+	+	+	1	
	專題製作(Special Topic Study)	\vdash			-	 	-							4	4	2	2	+		
	PCB電路佈線實務(PCB Layout Practice)	\vdash		-		\vdash	-									3	3	+		
	計算機輔助電路設計(Computer Circuit Aided Design) 到其萬文建縣(Advanced Technical English)	+	-	-	-	1	-	-								3	3	+	1	
	科技英文進階(Advanced Technical English) 東顯實務(Spacial Project Practica)	+	-	-	-	1	-	-						\vdash		3	3	+	1	
	專題實務(Special Project Practice)			1.5	1.5	10	10	0.4	0.4	10	10	0.1	0.1	10	10	4	4			
	合 計	6	6	15	15	12	12	24	24	12	12	21	21	13	13	13	13			

¹ 畢業應修130學分。

² 共同必修 14學分,專業必修116學分。